

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部份。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL
CORPORATION**

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中芯國際集成電路製造有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海

二零二零年七月八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）

趙海軍（聯合首席執行官）

梁孟松（聯合首席執行官）

高永崗（首席財務官兼聯席公司秘書）

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別

中芯国际集成电路制造有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1278 号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本

次发行的联席主承销商（海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”）。

本次公开发行业股份全部为新股，拟公开发行股票 168,562.00 万股，约占发行后总股本的 23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予联席主承销商初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 193,846.30 万股，约占发行后总股本 26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为 84,281.00 万股，占初始发行数量的 50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 84,281.00 万股，与初始战略配售股数相同。

则网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 67,424.80 万股，占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 61.54%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 16,856.20 万股，占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的 20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 42,140.50 万股，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.46%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 25,284.30 万股，占初始发行股份数量的 15%。

中芯国际于 2020 年 7 月 7 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中芯国际” A 股 42,140.50 万股（含超额配售选择权部分）。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由海通证券包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公

司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,355,092 户，有效申购股数为 238,575,348,500 股。网上发行初步中签率为 0.17663392%。配号总数为 477,150,697 个，号码范围为 100,000,000,000-100,477,150,696。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为 168,562.00 万股，其中：战略配售数量为 84,281.00 万股，网下初始发行数量为 67,424.80 万股，网上初始发行数量为 16,856.20 万股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 193,846.30 万股。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 25,284.30 万股，约占初始发行股份数量的 15%。回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上发行数量为 42,140.50 万股，约占超额配售选择权启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.46%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售数量为 84,281.00 万股，占初始发行数量的 50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%，因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

由于网上投资者初步有效申购倍数为 566.14 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,428.10 万股）股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 58,996.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.85%，占本次发行总

量的 30.43%；网上最终发行数量为 50,568.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 46.15%，占本次发行总量 26.09%。

网上、网下回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.21196071%。

四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2020 年 7 月 8 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：中芯国际集成电路制造有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020 年 7 月 8 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯国际集成电路制造有限公司



2020年 7 月 8 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2020年7月8日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年7月8日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2020年7月8日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020 年 7 月 8 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司



2020 年 7 月 8 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2020 年 7 月 8 日